

教育部 函

地址：100217 臺北市中正區中山南路5號
承辦人：陳景文
電話：02-7736-6180
電子信箱：wenchen@mail.moe.gov.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國114年4月1日
發文字號：臺教技(三)字第1142300709A號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：議程 (A09000000E_1142300709A_senddoc2_Attach1.pdf)

主旨：本部與經濟部、勞動部訂於114年4月22日（星期二）下午2時辦理「半導體產業人才培育交流座談會」，請貴校派員出席，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、為強化學界與產業界合作，每年由本部與經濟部、勞動部共同辦理各重點領域交流座談會，本場次針對半導體（包含材料、設計、製造、封測）領域所需人才，邀請產業公協會、重點廠商及大專校院代表就產業人才培育進行交流。
- 二、本次座談會相關資訊如下：
 - （一）時間：114年4月22日（星期二）下午2時。
 - （二）地點：明新科技大學鴻超樓1樓平面會議室（地址：新竹縣新豐鄉新興路1號）。
- 三、出席人員：為促進產學交流，請貴校協助宣達半導體、電子、電機、機械、化學、物理等涉及半導體相關科系主管或專業領域教授報名。
- 四、報名方式：採線上報名（網址：<https://forms.gle>

國立清華大學



1140006343

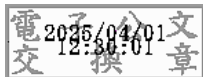


/LxtB2Z6Ldxw2ew6t7) ，即日起至114年4月17日 (星期四) 止。

五、若有相關問題，請洽教育部促進產學連結合作育才平臺辦公室江小姐 (02-27301011) 。

正本：國立中央大學、國立中興大學、國立虎尾科技大學、國立高雄科技大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立勤益科技大學、國立彰化師範大學、國立臺北科技大學、國立臺灣科技大學、中信金學校財團法人中信科技大學、中原大學、中華大學學校財團法人中華大學、元智大學、正修學校財團法人正修科技大學、亞東學校財團法人亞東科技大學、明志科技大學、明新學校財團法人明新科技大學、長庚大學、南臺學校財團法人南臺科技大學、健行學校財團法人健行科技大學、逢甲大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、黎明技術學院、龍華科技大學

副本：國立臺北科技大學育才平臺執行辦公室、國立臺灣科技大學育才平臺執行辦公室



裝

訂



線